

EDITORIAL

Wearable Electronic – Smart Textile 4.0 2057

VERBÄNDE

 **FBDi** - Informationen 2101
Fachverband Bauelemente Distribution e.V.

 **FED** - Informationen 2116

 **ZVEI** - Informationen 2142
Die Elektroindustrie

 **MAPS** - Mitteilungen 2174
DEUTSCHLAND

 **3-D MID** - Informationen 2189

 **DVS** - Mitteilungen 2210

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 2060

Neue Normen 2071

Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 2072

Innovationen der electronica 2076

BAUELEMENTE

Mit Authentisierungs-Chips, energieeffizienten Super-Logik-Computern und GPS-Ersatzlösungen die Sicherheit erhöhen 2088

Vielseitige Speicher-Neuheiten für diverse Anwendersegmente 2095

Neues von der Analog-IC-Front 2097

LEDs – Leistungssteigerung ermöglicht infrarote Ausleuchtung über 100 Meter 2100

DESIGN

MultiSIM Blue bietet moderne Schaltungssimulation mit integriertem PCB-Design und BOM 2103

Erster IPC-Standard für die Abnahme von Solarmodulen 2105

Design for Assembly von Leiterplatten 2106

DESIGN

Extrem flache LED-Leuchte im CD-Format 2113

Referenzdesign-Lösung für industrielle Remote-I/O-Bausteine 2114

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H.J. Friedrichkeit): 48-Volt-Bordnetz eröffnet vielfältige Möglichkeiten 2119

Die Leiterplattenindustrie 2013 2123

Steckhilfe, Auszieher und Sicherungsabdeckung in einem für Leiterplatten 2128

Isola Technologietag 2014 – Basismaterial für Power Electronics 2130

Die Anwendung gedruckter Wärmeleitpasten zur Verbesserung der Wärmeableitung auf Leiterplatten 2134

Weiterentwicklung in Hochtechnologie und Eilfertigung angepeilt 2139

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Workshop Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) in der Leistungselektronik 2146

Was bietet Lötten mit Vakuumprofilen? 2152

1st Hand Soldering Competition 2014 – weitere Wettbewerbe geplant 2156

Positionspapier vereinfacht Vergleich und Auswahl bleifreier Legierungen 2158

Automatisches Bestücken von vorgedruckten Etiketten 2160

Schablonen – Hand- oder Maschinenreinigung? 2161

ATX-Mainboard für den 24/7-Dauerbetrieb in Applikationen mit hoher CPU-Rechenleistung 2163

Die Evolution der Löttechnik geht weiter 2164

Aluminium als Werkstoff für Stanzgitter in der Elektronik für die Automobilindustrie 2167

ANALYTIK & TEST

Innovationskraft und Qualität als entscheidende Faktoren 2181

Testverfahren für große Testabdeckung bei hochkomplexen Elektroniksystemen 2185

Brillante Bilder auch ohne Mikroskop 2187

CE-Konformitätsprüfsystem 2188

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Integration von Elektronik in Textilien für ‚Wearable‘ und großflächige Anwendungen	2192
Abnahme bioelektrischer Signale und Stimulation mittels textiler Elektroden	2200
Patente	2205

FORUM

Wie Akkus in Laptops und Smartphones länger durchhalten	2211
Industrie 4.0 beginnt im Kopf – Vernetzte Produktionsplanung in der Elektronikfertigung als strategischer Erfolgsfaktor	2214

FORUM

Microelectronics Saxony – Kontakte sind unverzichtbar	2215
Neue Halbleitermaterialien – deutsche Forscher halbieren Energieverluste	2219
ZVEI-Kongress 2014 – nach den Wahlen wurden Zukunftsthemen diskutiert	2220
Kolumne: Hier geht es um die Wurst	2223
PLUS-Firmenverzeichnis	2226
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	2250
Inserentenindex	2252
Mediadaten	2254
Impressum	2255
Produkt des Monats	2256

Titelbild: FlowCAD bietet Protokoll Analyzer für USB, PCIe, DDR, Fibrechannel und weitere Schnittstellen, um die Übertragung aufzuzeichnen, zu analysieren und zu optimieren. So wird kann die maximale Übertragungskapazität der Schnittstellen erreicht werden.

Weitere Informationen: www.FlowCAD.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente
Distribution e.V.
Tel. +49 (0) 8563 9788908
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49/69/6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49/30/8349059
info@fed.de, www.fed.de



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49/69/6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e.V.
Tel. +49/3677/69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49/91 1/5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de



European Interconnect
Technology Initiative e.V.
Tel. +49/69/6302-281
eiti@zvei.org, www.eiti.org



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49/211/1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

Die offiziellen Verbandsmitteilungen an Mitglieder und Fachwelt erscheinen monatlich in der PLUS.